

助成事業「万博を契機としたものづくり中小企業の技術開発支援事業」について

地方独立行政法人大阪産業技術研究所
理事長

標題について、下記企業を採択いたします。

記

No.	採択企業 ○：代表企業	助成事業の課題名
1	日光化成株式会社	電子基板の効率的なリサイクルを可能とする高速通信対応の熱硬化性プライマーの開発
2	東邦化成株式会社	高速通信（Beyond 5G）用低誘電損失型プリント配線基板ならびにその材料開発
3	○株式会社電子技研 株式会社友電舎	Beyond 5G 移動通信システムの実現に向けた低誘電率樹脂多層フレキシブルプリント配線基板作製のための直接接着技術及びプリント基板作成技術の開発
4	○株式会社イオックス 株式会社渡辺護三堂	Beyond 5G 対応の電磁波シールド、メタサーフェス反射板製造用めっきプライマーの開発
5	○ポリプラ・エボニック株式会社 株式会社ダイセル ポリプラスチック株式会社 ダイセル・オルネクス株式会社	ポスト 5G/6G ミリ波・テラヘルツ帯向け低誘電材料の開発

以上